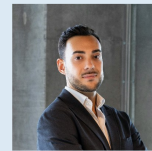


## Elektroonikainseneer

# Silver Kuusk



### KOGEMUS

**Vanem elektroonikainseneer**, Ericsson Estonia, Tallinn *sept 2019 – Praeguseni*  
Arendan Ericssoni 5G raadioseadmete elektroonikamooduleid globaalse R&D meeskonna liikmena Tallinna arendusbüroos.

- Projekteerisin RF-võimendi ringluse optimeermise, mis vähendas komponendi energiatarvet **22%** ilma jõudlust kaotamata
- Juhtisin FPGA loogika arendamist Xilinx Ultrascale+ platvormil **3 tootegeneartsiooni** raames
- Koostöös firmware tiimiga rakendanud reaalajas diagnostikaprotokolle, vähendades välitestide aja **35%**
- Teinud PCB paigutuse optimeerimist (Altium Designer), saavutades **4-kihi PCB** mahtumise **6-kihi** asemel
- Mentorleesin **2 nooremsenerit** RF mõõtmiste ja EMC katsetuste alal
- Arendas koostöös **Cybernetica** inseneridega turvalahendusi IoT-seadmetele

**Elektroonikainseneer**, Skeleton Technologies OÜ, Tallinn *juuni 2016 – aug 2019*  
Töötasin ultrakondensaatori energiasalvestussüsteemide elektroonika arendusmeeskonnas, vastutades BMS (Battery Management System) elektroonika eest.

- Projekteerisin **BMS riistvara** 400V ultrakondensaatori moodulitele tööstuslikuks kasutuseks
- Teostasin EMC pre-compliance teste ja parandanud disaini, vähendades emissioone **CE-märgistuse nõuete** täitmiseks
- Arendanud manussüsteemide firmware (C, STM32) andmekogumis- ja kaitsefunktsioonideks
- Koordineerinud **väliste PCB tootjatega** prototüüpide tootmist Hiinas ja Soomes

**Nooremsener – manussüsteemid**, Starship Technologies, Tallinn *juuli 2014 – mai 2016*  
Alustasin karjääri Eesti robotikaiduettevõttes, töötades kullerroboti elektroonika ja sensorisüsteemide arendusmeeskonnas.

- Arendanud ultrahelianduri integratsioon robotile, parandades takistuste tuvastamist **40%**
- Katsetanud elektroonikamooduleid **500+ tundi** välistes keskkonnatingimustes (külm, niiskus, vibratsioon)
- Osalenud **3 toote väljalaske tsüklis** elektrikaabi ja PCB komponentide valideerimisega

### SERTIFIKAADID

**IPC-A-610 elektroonika kvaliteedikontroll**, IPC *juuni 2020 – juuni 2020*  
**Altium Designer sertifikaat**, Altium *märts 2021 – märts 2021*

### PROJEKTID

**Jätkusuutlikkuse algatus ja ESG-aruandlus** *jaan 2022 – dets 2022*  
Juhtis jätkusuutlikkuse algatust, keskendudes **ESG-aruandlusele** ja CO<sub>2</sub> jalajälje vähendamisele. Saavutas **15% ressursikasutuse vähendamise** ja parandas organisatsiooni jätkusuutlikkuse profiili.

### HUVITEGEVUS

**Mentor üliõpilastele**, Tallinna Tehnikaülikool *jaan 2021 – dets 2023*  
Juhendas elektroonikainseneer eriala üliõpilasi karjäärinõustamise ja erialase arengu teemadel.

### PROFIIL

Elektroonikainseneer üle **8-aastase** kogemusega manussüsteemide arendamisel ja analoogringluste projekteerimisel Ericsson Estonia tiimis ning Eesti mehhatroonikasektoris. Spetsialiseerunud FPGA programmeerimisel, DSP-töötlusel ja madala energiatarbimisega IoT seadmete riistvaraarenduses. Tugev oskus viia projekte kontseptsioonist kuni prototüübi ja masstootmiseni.

### HARIDUS

**Magistrikraad erialal Elektroonika ja kommunikatsioon**  
Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Tallinn *sept 2012 – juuni 2014*  
**Bakalaureusekraad erialal Mehhatroonika**  
Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Tallinn *sept 2009 – juuni 2012*

### OSKUSED

- FPGA arendus (Xilinx, Intel)
- PCB projekteerimine (Altium Designer)
- Analoog- ja digitaalringlused
- Manussüsteemide firmware (C, C++)
- RF ja kõrgsagedusringlused
- EMC katsetused ja vastavus
- LTspice (simulatsioon)
- VHDL / Verilog
- IoT sensorisüsteemid
- Python (testimine ja automatiseerimine)

### KEELED

- Eesti keel (emakeel)
- Inglise keel (C1)
- Vene keel (A2)

### SOOVITAJAD

**Raul Veede**  
R&D juht, Milrem Robotics,  
raul.veede@milrem.com, +372 5456 7890

**Anne Jõgi**  
Tootearenduse direktor, Skeleton Technologies, anne.jogi@skelcap.com, +372 5567 8901